

はんだ関連文献リスト

参考資料

No.	件名	リンク先	備考
1	はんだ接合部の劣化・寿命診断方法の開発(東芝レビューVol.56 No.12 (2001))	https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/corp/techReviewAssets/tech/review/2001/12/56_12pdf/f02.pdf	文献① P62～63 3.3項
2	電子部品はんだ接合部の熱疲労寿命解析(豊田中央研究所R&DレビューVol.31 No.4(1996.12))	https://www.tytlabs.co.jp/en/japanese/review/rev314pdf/314_043yamada.pdf	文献② P52
3	電子装置の腐食抑制技術(材料と環境(2016))	https://www.jstage.jst.go.jp/article/jcorr/65/6/65_229/_pdf	文献③ P229
4	プリント回路板の絶縁劣化要因としてのイオンマイグレーション –その発生メカニズムと抑制策–(回路実装学会誌10(2) 1995)	https://www.jstage.jst.go.jp/article/jiep1995/10/2/10_2_80/_pdf/-char/ja	文献④ P80
5	金属接合部のエレクトロマイグレーション発生メカニズムの基礎と信頼性課題(第28回エレクトロニクス実装学会春季講演大会依頼講演資料)	https://www.jstage.jst.go.jp/article/ejisso/28/0/28_308/_pdf/-char/ja	文献⑤ P308
6	信頼性ハンドブック(Rev.2.50 ルネサスエレクトロニクス2017.01)	https://www.renesas.com/jp/ja/document/grl/semiconductor-reliability-handbook	文献⑥ 3-9 3.2.4項
7	はんだミニチュア材の強度試験技術	https://www.kobelcokaken.co.jp/tech_library/pdf/no33/a.pdf	
8	はんだ接合部の熱疲労強度の評価	https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms1963/30/331/30_331_330/_pdf/-char/ja	
9	経年変化を受けたはんだ接合部の疲労強度評価	https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmezairiki/2004/0/2004_253/_pdf/-char/ja	
10	電子部品はんだ接続部の経年劣化	https://www.jstage.jst.go.jp/article/materia1994/36/4/36_4_288/_pdf	
11	鉛フリーはんだ接合部の機械的信頼性	https://www.jstage.jst.go.jp/article/jiep1998/4/4/4_4_262/_pdf	
12	鉛フリーはんだの高サイクル疲労特性	https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmetohoku/2004.40/0/2004.40_25/_pdf/-char/ja	
13	製品開発のための材料力学と強度設計ノウハウ	図書	
14	フラクトグラフィ 破面と破壊情報解析	図書	